

La machine à coller sans colle, innovation qui décolle

LA CHAUX-DE-FONDS Sy&Se, qui déménagera sur le Littoral en 2023, a trouvé un gros client dans l'électronique pour son adhésif.

L'entreprise SY&SE, à La Chaux-de-Fonds, annonce un partenariat avec le groupe allemand Süss MicroTec, qui emploie environ 1200 personnes en Allemagne, à Taïwan et à Neuchâtel. Süss MicroTec, fournisseur de machines destinées à la fabrication de puces et capteurs électroniques miniaturisés intégrera à ses équipements la technologie d'Impulse Current Bonding ICB, ou collage par impulsion électrique. Inventé

en 2016 à la HE-Arc, il a été industrialisé par SY&SE, qui s'est vu décerner pour cela le Prix BCN Innovation 2018. **Bientôt dans le Bas** «Nous ne sommes plus une start-up, mais une petite entreprise en pleine croissance», se félicite Peter Kupferschmied, membre de la direction. L'entreprise, qui occupe huit personnes, déménagera sur le Littoral au cours de l'année 2023. En prenant place dans les

équipements de Süss, SY&SE pourra fournir aux fabricants d'électronique son procédé de collage sans colle à basse température, afin de lier des couches de verre et de silicium. «Les techniques actuelles nécessitent une température d'environ 400 degrés. Notre procédé à basse température permet de raccourcir le temps nécessaire, simplifie le processus de fabrication et évite les déformations qu'on peut observer lors du refroidissement», explique Peter Kupferschmied.



Stratégie d'exclusivité Stefan Lutter, responsable des processus de collage chez Süss MicroTec, indique: «Nous sommes

fiers de devenir le partenaire exclusif de SY&SE pour mettre à disposition de notre industrie une technologie de rupture qui peut s'adapter à de nombreux systèmes.» L'électronique pourrait devenir

Grâce au groupe allemand Süss MicroTec, Sy&Se met un pied dans l'énorme marché des équipements de fabrication de la microélectronique. KEYSTONE

un champ d'application très important de cette technologie neuchâteloise. «Nous poursuivons une stratégie qui vise à trouver un gros client pour chaque domaine d'application», indique Peter Kupferschmied. **LOÉ**